

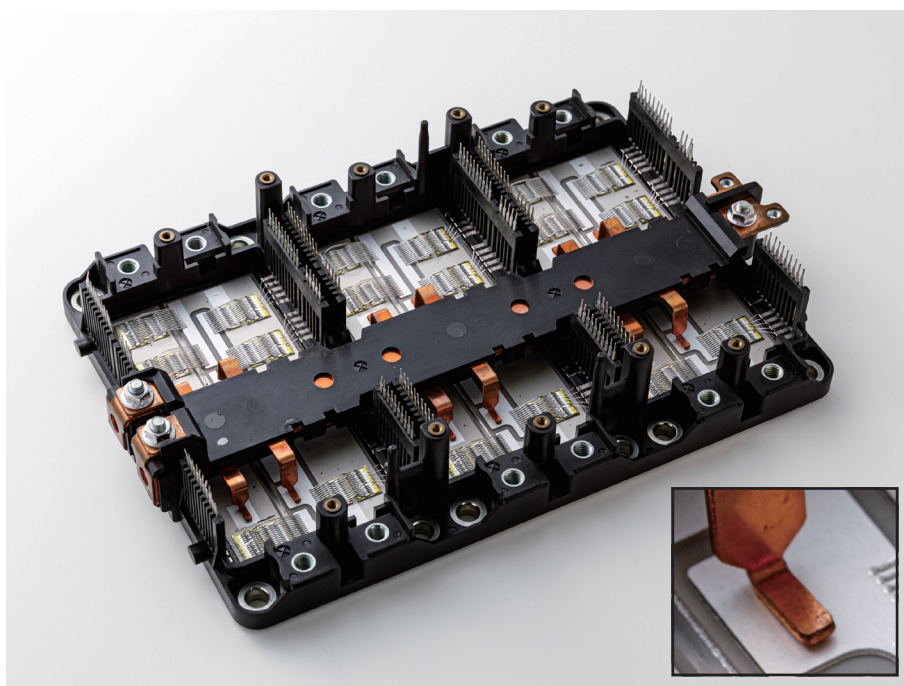


Application

Bonding ボンディング

パワー半導体のバスバー多点 音波接合

世界初 車載パワーモジュールの量産



ハイブリッド車搭載 15年間トラブルゼロで生産稼働中！

Product used 使用する装置

30MZs/40MZs

